

TSRI-CTU JRC 2026年徵案計畫

線上說明會公告

2025.09

本中心(TSRI)與布拉格捷克理工大學(Czech Technical University in Prague, CTU)自2025年起成立聯合研究中心並推動雙邊研究合作計畫，迄今已展現良好成效。為延續合作基礎並深化雙方交流，今年決議續辦並徵求2026年度的雙邊研究合作計畫。

本徵案計畫旨在透過學術合作與本中心服務平台，建立團隊間長期穩定的夥伴關係，並促進雙邊科研資源與優勢共享。本案之申請團隊須為台方大專院校與CTU教授共同合作組成，雙邊共同執行同一計畫主題，並由台方計畫主持人為申請者，在期限內提交研究計畫申請書，以進行後續評選。徵案之研究主題包含晶片設計領域以及晶片製造領域。

因配合雙方內部作業流程，將於2025年12月19日確認審查獲選名單，入選團隊將會進行限制性招標，計畫期程自決標日起，於7月3日前繳交期中查驗報告，並於11月20日前繳交期末驗收報告，計畫截止日為2026年11月20日。

本中心預計於2025年10月9日(四)舉辦線上說明會，並邀請有意願參與徵案的教授或其研究團隊所推派的研究生在說明會中簡短介紹其研究主題，相關說明如下：

一、線上說明會時間：2025年10月9日(四) 16:00-18:00 (GMT+8)

二、線上說明會報名時間：即日起至2025年10月7日(二) 23:59 (GMT+8)

三、線上說明會報名網址：<https://forms.gle/XvKy41vhMfj6evDt8>

四、線上說明會檔案上傳方式：

請有意於線上說明會簡要介紹研究主題的教授或研究生，透過上方報名連結上傳約一至兩分鐘的投影片檔案。

五、研究主題領域：

1. 晶片設計領域：Analog Design, Digital Design, MEMS Sensors, Silicon Photonics 及其他設計領域相關主題
2. 晶片製造領域：Semiconductor Manufacturing Technology, Technology Computer-Aided Design (TCAD) 及其他製造領域相關主題

六、補助計畫內容：

1. 每件計畫補助研究經費最高新臺幣壹佰玖拾萬元。
2. 依計畫申請書之晶片下線需求規劃（如有），TSRI將配合研究計畫實際執行進度補助每案最高新台幣貳佰萬元整之TSRI晶片下線額度，以支持研究團隊進行晶片

實作發表。

七、雙邊團隊媒合平台：

1. 請有意參與研究的團隊進入下方連結網址進行研究主題與聯絡資訊的填寫，以利雙邊團隊媒合：<https://reurl.cc/GNvzxD>
2. 請有意參與研究的團隊進入下方連結網址上傳研究領域介紹投影片檔案，以利雙邊團隊媒合：<https://reurl.cc/6qMp05>

八、聯繫窗口：

聯絡電話：03-5773693 #7779(葉先生) #7170(江小姐)

E-mail：tsri.ctu_jrc@niar.org.tw